

论文

考虑外包混合形式的TOC产品组合优化研究

王军强, 孙树栋

西北工业大学 机电学院

收稿日期 2006-7-31 修回日期 2006-12-25 网络版发布日期 2007-10-10 接受日期

**摘要** 首先, 根据外包的两种形式(带料外包、不带料外包)研究了外包混合形式下产品组合优化的建模问题, 并通过数学证明其有效产出最优。其次, 应用免疫算法(IA)对其进行了优化求解, 在合理时间内得到大、小规模产品组合决策的最优解或近优解。最后, 将本算法与传统TOCh、修订TOCh、整数规划(IP)、禁忌搜索(TS)、遗传算法(GA)等进行了仿真比较, 证明了本算法的有效性和实用性。

**关键词** [产品组合优化](#) [约束理论](#) [免疫算法](#) [免疫应答](#) [外包](#) [建模](#) [仿真](#)

**分类号** [TH166](#) [TP301.6](#) [TP391.9](#)

**DOI:**

通讯作者:

王军强 [wangjunqiang@hotmail.com](mailto:wangjunqiang@hotmail.com)

作者个人主页: 王军强; 孙树栋

扩展功能

本文信息

- ▶ [Supporting info](#)
- ▶ [PDF\(4490KB\)](#)
- ▶ [\[HTML全文\]\(0KB\)](#)
- ▶ [参考文献\[PDF\]](#)
- ▶ [参考文献](#)

服务与反馈

- ▶ [把本文推荐给朋友](#)
- ▶ [加入我的书架](#)
- ▶ [加入引用管理器](#)
- ▶ [引用本文](#)
- ▶ [Email Alert](#)
- ▶ [文章反馈](#)
- ▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

- ▶ [本刊中 包含“产品组合优化”的相关文章](#)
- ▶ 本文作者相关文章
- [王军强, 孙树栋](#)